



台積公司

台積公司歷久不衰的商業模式、跨產業的設計生態系統夥伴關係，以及涵蓋誠信正直、承諾、創新與客戶信任的核心價值都是讓我們成為「大家的代工廠」之堅實基礎，並且創造台積公司與積體電路創新者之間雙贏的夥伴關係。

公司概況

2.1 公司簡介

民國七十六年，台積公司成立於台灣新竹科學工業園區，並開創了專業積體電路製造服務商業模式。台積公司專注生產由客戶所設計的晶片，本身並不設計、生產或銷售自有品牌產品，確保不與客戶直接競爭。時至今日，台積公司已經是全世界最大的專業積體電路製造服務公司，單單在民國一百零六年，台積公司就以258種製程技術，為465個客戶生產9,920種不同產品。

台積公司的眾多客戶遍布全球，為客戶生產的晶片被廣泛地運用在電腦產品、通訊產品、消費性、工業用及標準類半導體等多樣電子產品應用領域。如此多樣化的晶片生產有助於緩和需求的波動性，使公司得以維持較高的產能利用率及獲利率。

民國一百零六年，台積公司及其子公司所擁有及管理的年產能超過1,100萬片十二吋晶圓約當量。台積公司在台灣設有三座十二吋超大晶圓廠 (GIGAFAB® Facilities)、四座八吋晶圓廠和一座六吋晶圓廠，並擁有一家百分之百持有之海外子公司—台積電(南京)有限公司之十二吋晶圓廠及二家百分之百持有之海外子公司—WaferTech美國子公司、台積電(中國)有限公司之八吋晶圓廠產能支援。其中於民國一百零五年成立的台積電(南京)有限公司，下設有一座十二吋晶圓廠以及一個設計服務中心。

台積公司在北美、歐洲、日本、中國大陸，以及南韓等地均設有子公司或辦事處，提供全球客戶即時的業務與技術服務。至民國一百零六年年底，台積公司員工總數超過4萬8,000人。

台積公司股票在台灣證券交易所上市，股票代碼為2330，另有美國存託憑證在美國紐約證券交易所掛牌交易，股票代號為TSM。

2.2 市場概況

2.2.1 台積公司卓越表現

民國一百零六年，即使面對既有競爭者及新進競爭者的挑戰，台積公司在全球半導體業之積體電路製造服務領域，仍估計以56%的市場佔有率持續保持領先地位。

擁有最先進的製程技術是台積公司在專業積體電路製造服務領域保持領先地位的重要關鍵。民國一百零六年，有58%的晶圓營收來自先進製程技術(28奈米及以下更先進製程)，高於民國一百零五年的54%。

基於專注客戶信任，台積公司於民國一百零六年持續強化「開放創新平台」(Open Innovation Platform® initiative)以提供更多的創新服務。台積公司於九月在加州聖塔克拉拉，以及十一月在深圳舉辦了民國一百零六年度的開放創新平台生態論壇(Open Innovation Platform® Ecosystem Forum)。此年度盛會展現了台積公司如何和生態夥伴們透過開放創新平台(OIP)共同在台積公司先進製程的基礎上發展設計解決的方案。台積公司高階主管主講台積公司的設計實現平台，以及台積公司和OIP夥伴們在每個平台所提供相對應的解決方案。來自台積公司電子設計自動化(EDA)及矽智財(IP)夥伴的三位高階主管緊接著發表專題演講，強調與台積公司長期以來的合作，共同幫助客戶創新並掌握市場的商機。

台積公司提供客戶專業積體電路製造服務領域中最全面的製程技術，並且持續投資先進及特殊製程技術，這是台積公司得以為客戶創造更多附加價值並有別於競爭對手的主要關鍵。

台積公司於民國一百零六年開發與已提供的製程包括：

邏輯製程技術

- 5奈米鰭式場效電晶體製程技術(5nm FinFET)開發順利，並預計於民國一百零八年第一季開始試產。相較於7奈米FinFET技術，5奈米FinFET技術速度增快超過15%，或者功耗降低約30%。此外，5奈米FinFET技術自規劃開始，便同時針對行動運算應用與高效能運算元件提供優化的製程選項。
- 7奈米FinFET製程技術已順利完成開發，並於民國一百零六年四月按計劃開始試產。客戶採用此一製程情形相當踴躍，總計民國一百零六年接獲超過十個產品投片。由於7奈米FinFET技術與10奈米FinFET技術有超過95%的機台設備均相容，因此預期7奈米FinFET技術的良率改善會相當快速。相較於10奈米FinFET技術，7奈米FinFET技術速度增快約25%，或者功耗降低約35%。此外，7奈米FinFET技術能針對行動運算應用或高效能運算元件，分別提供優化的製程。
- 10奈米FinFET製程技術已於民國一百零六年第一季開始大量出貨。由於採取更積極的製程微縮，此一製程技術能夠協助客戶達到最佳密度與成本優勢，並能支援客戶包括行動裝置、伺服器及繪圖晶片等效能驅動的應用市場。
- 12奈米FinFET精簡型製程技術(12nm FinFET Compact, 12FFC)於民國一百零六年第二季完成所有驗證，並於同一年下半年進入量產。12FFC係台積公司繼16奈米FinFET強效版製程技術(16FF+)及16奈米FinFET精簡型製程技術(16nm FinFET Compact, 16FFC)之後，所推出的最新16奈米系列製程技術，擁有晶圓代工領域16/14奈米製程技術中最佳晶片面積與功耗優勢。16FF+係於民國一百零四年開始量產，此一技術能夠支援客戶高效能市場應用，包括行動裝置、伺服器、繪圖晶片，以及加密貨幣等產品；具備成本效益的16FFC則於民國一百零五年第一季開始量產，此一技術同時進行晶片線寬微縮及製程簡化，因此能夠在降低晶片成本方面發揮最大效益。16FFC及12FFC皆能支援客戶主流及超低功耗(Ultra-Low-Power, ULP)產品應用，包括中、低階手機、消費性電子、數位電視、物聯網等。由於具備創新的標準元件資料庫架構，12FFC能夠用於更先進的產品應用。總計目前16FF+/16FFC/12FFC已接獲超過200個客戶產品投片，其中絕大部分都是第一次投片即生產成功。

- 22奈米超低功耗製程技術(22nm Ultra-Low Power, 22ULP)發展係基於台積公司領先業界的28奈米製程，並預計於民國一百零七年下半年量產。與28奈米高效能精簡型製程技術(28nm High Performance Compact, 28HPC)相較，22ULP技術擁有晶片面積縮小10%，及效能提升超過30%或功耗降低超過30%的優勢，以滿足影像處理器、數位電視、機上盒、智慧型手機、物聯網及消費性產品等應用。
- 22奈米超低漏電製程技術(22nm Ultra-Low Leakage, 22ULL)順利開發中。與40奈米ULP及55奈米ULP製程相較，新的ULL元件和ULL靜態隨機存取記憶體(SRAM)可以大幅降低功耗。22ULL技術能夠支援物聯網及穿戴式裝置相關產品應用，並預期於民國一百零七年下半年開始試產。
- 28奈米高效能精簡型強效版製程技術(28HPC+)截至民國一百零六年，總計接獲超過150個客戶產品投片。28HPC+技術進一步提升主流智慧型手機、數位電視、儲存裝置、音效處理及系統單晶片等產品應用的效能或降低其功耗。與28HPC製程相較，28HPC+技術能夠進一步提升15%效能或降低功耗50%。同時，28HPC+技術提供低電壓設計的能力，能夠支援超低功耗的物聯網產品應用。此外，此一製程與台積公司28奈米的設計生態環境無縫接軌，以協助客戶加速產品上市時間。
- 40奈米超低功耗製程技術(40ULP)於民國一百零六年接獲超過20個客戶產品投片。此一技術支援物聯網及穿戴式裝置相關產品應用，包含無線網路連接產品、應用處理器及感測器中樞(Sensor Hub)等。此外，台積公司採用領先的40ULP近閾值電壓技術(Near Threshold Voltage, Near-Vt)，為客戶推出全球物聯網產品及穿戴式聯網產品最低功耗的解決方案。全新的強化型類比元件順利開發中，將進一步強化40ULP平台，以支援客戶未來更廣泛的類比電路設計。
- 55奈米超低功耗製程技術(55ULP)已開始生產，截至民國一百零六年，總計接獲超過40個客戶產品投片。相較於55奈米低功耗製程(55LP)，此一製程技術可大幅延長物聯網相關產品的電池使用壽命。此外，55ULP亦整合了射頻製程與嵌入式非揮發性快閃記憶體製程，能讓客戶的系統單晶片設計更為簡單。

特殊製程技術

- 16FF+技術自民國一百零六年起已為客戶生產汽車產業應用產品。16FFC基礎矽智財 (Foundation IP) 已通過汽車電子協會 (Automotive Electronic Council, AEC) AEC-Q100 Grade-1 驗證，並且獲得功能性安全標準 ISO26262 ASIL-B 認證。此外，也導入TSMC 9000A品質管理系統來規範車用矽智財，透過和第三方矽智財供應商合作來建立車用設計生態環境。
- 16FFC射頻製程技術 (16FFC RF) 除了支援智慧型手機、第五代行動通信技術 (5G) 等無線連接應用之外，進一步拓展至新一代無線區域網路802.11ax (Wireless Local Area Network, WLAN 802.11ax) 及毫米波 (Millimeter Wave, mmWAVE) 等應用。
- 22奈米射頻製程技術 (22ULP RF) 提供高截止頻率 (Ft) 元件、更有彈性的製程設計套件 (Process Design Kit, PDK) 和可靠的模擬模型，滿足第五代行動無線通訊、毫米波、高頻收發器 (RF TRx) 和物聯網應用晶片的開發與量產。
- 28奈米射頻製程技術 (28HPC RF, 28HPC+ RF) 提供超過300吉赫 (Gigahertz, GHz) 的高頻元件，支援智慧型手機、車用裝置，以及物聯網裝置等無線電子產品應用。
- 40奈米ULP嵌入式快閃記憶體製程技術 (Embedded Flash)，已於民國一百零五年開始量產，相關應用包含無線通訊微控制器 (Wireless MCU)、物聯網裝置、穿戴式裝置以及高性能微控制器 (High Performance MCU)。此一技術預計於民國一百零七年取得汽車電子協會 AEC-Q100 驗證。
- 40奈米ULP非揮發性嵌入式可變電阻式記憶體製程技術 (Resistive Random Access Memory, RRAM)，已於民國一百零六年底完成技術開發，進入試產階段。相關應用包括無線通訊微控制器、物聯網裝置以及穿戴式裝置。
- 0.13微米單光子崩潰二極體 (Single-Photon Avalanche Diode, SPAD) 技術平台可協助客戶加速開發光學雷達 (Light Detection and Ranging, LiDAR) 產品應用。三維影像的成像及感測在機械視覺上扮演越來越重要的角色，而LiDAR就是促成這些應用的關鍵技術。客戶可以透過台積公司領先產業的SPAD技術平台設計SPAD感測器產品，以取得最佳的產品上市優勢，藉此擴展LiDAR在汽車及安防監控產業的廣大應用。

- 十二吋0.13微米雙載子-互補式金氧半導體-擴散金屬氧化半導體強化版 (Bipolar-CMOS-DMOS Plus, BCD Plus) 製程技術通過客戶驗證。相較於前一代，此一製程技術提供更優異的成本競爭優勢，並於民國一百零六年下半年開始生產。
- 0.18微米第三代BCD製程技術已通過客戶驗證。相較於第二代，此一製程技術提供更優異的成本競爭優勢，並於民國一百零六年下半年開始量產。
- 除了應用廣被的電容式 (Capacitive) 指紋辨識技術，台積公司更進一步提供領先業界的光學指紋辨識 (Optical Fingerprint Sensing) 的整合方案，涵蓋0.18微米及0.11微米互補式金氧半導體影像感測器 (CMOS Image Sensor) 以及光準直器 (Collimator)，協助客戶產出客製化的光學指紋辨識器。對許多電子通訊及電子付費系統應用而言，指紋辨識器是身分辨識功能不可或缺的要件。
- 壓電製程技術 (Piezo Technology) 已於民國一百零六年建立試產線，協助客戶設計與開發應用於微型揚聲器、麥克風、超音波感測器及醫療／健康應用的各式致動器 (Actuator)。壓電技術在微機電系統 (MEMS) 領域屬於新的應用，且有相當高的成長潛力。新式壓電薄膜 (Piezoelectric Thin Film) 材料已完成初期製程開發之特性研究，因此客戶可專注於產品設計及架構，以取得最佳的產品上市優勢。

先進封裝技術

- 針對先進行動裝置的應用，整合10奈米系統單晶片和動態隨機存取記憶體 (DRAM) 的第二代整合型扇出層疊封裝技術 (Integrated Fan-Out PoP, InFO-PoP) 已於民國一百零六年第二季開始量產。
- 針對高效能運算的應用，能夠異質整合12奈米系統單晶片與四顆堆疊八層 (8-hi) 的第二代高頻寬記憶體 (HBM2) 於約1500平方厘米大中介版 (Interposer) 的 CoWoS® 技術已於民國一百零六年上半年開始量產。此外，於民國一百零六年成功開發能整合超過四顆堆疊八層的第二代高頻寬記憶體的CoWoS® 技術。
- 除了CoWoS® 技術外，預計於民國一百零七年完成能夠整合多顆單晶片的整合型扇出暨封裝基板 (InFO on Substrate, InFO_oS) 技術的驗證。

- 採用細小間距陣列銅凸塊 (Cu bump) 覆晶封裝的10奈米及更成熟製程晶圓於民國一百零六年持續量產。此外，7奈米銅凸塊製程已經通過驗證，並將於民國一百零七年開始生產。適用於高階智慧型手機應用的28奈米及更成熟製程晶圓級封裝 (Wafer Level Chip Scale Packaging, WLCSP) 技術亦於民國一百零六年持續量產。16奈米晶圓級封裝技術已於民國一百零六年完成驗證，並將於民國一百零七年開始量產。

2.2.2 市場分析

民國一百零六年，台積公司預估全球半導體市場的產值約為美金4,340億元，在民國一百零五年成長相對平緩的情況下，民國一百零六年呈現強勁成長，年成長率為22%。其中，從事半導體製造的積體電路製造服務業產值約為美金530億元，年成長率為7%，接近民國一百零五年的年成長率8%。

2.2.3 產業未來展望、機會與挑戰

積體電路製造服務市場的需求與供給

積體電路製造服務領域這些年來的成長，主要是由健康的市場需求所驅動。民國一百零七年，台積公司預估整體半導體產業 (不含記憶體) 將成長5%。長期而言，因電子產品採用半導體元件的比率提升，無晶圓廠設計公司持續擴大市佔率，整合元件製造商委外製造的比例逐漸增加，以及系統公司增加特殊應用元件委外製造等因素，自民國一百零六年至民國一百一十一年，積體電路製造服務領域的成長可望較整體半導體產業 (不含記憶體) 的4% 年複合成長率更為強勁。

積體電路製造服務領域位居整個半導體產業鏈的上游，其表現與通訊、電腦、消費性電子產品等主要終端產品以及新興物聯網的市場狀況息息相關。

●通訊

通訊產業中，智慧型手機民國一百零六年的單位出貨量達3%的成長。雖然近年來成長力道趨緩，但智慧型手機持續演進至4G/LTE、LTE-Advanced，以及LTE-Advanced Pro，預期將推動市場於民國一百零七年呈現約低個位數百分比成長。擁有更高效能、更長電池壽命、生理感應器

及更多人工智慧應用的智慧型手機，將持續吸引消費者的購買興趣；同時，低階智慧型手機在新興市場國家的普及，亦會持續推動市場成長。

低耗電特性的晶片對手機製造商而言是不可缺少的一環。擁有最佳成本、耗電及外型尺寸 (晶片面積與高度) 潛力的系統單晶片設計，是首選的解決方案，而台積公司在此製程技術方面已居領導地位。對於人工智慧應用和各種複雜軟體運算與高解析度視訊處理的高效能需求，將持續加速先進製程技術的推進。

●電腦

繼民國一百零五年衰退6%之後，民國一百零六年電腦產業整體的單位出貨量減少3%。衰退的主要原因在於個人電腦的更替週期增長以及消費者逐漸傾向使用行動運算，但部分衰退被伺服器的正成長抵銷。

民國一百零七年，預期電腦產業將持續呈現低個位數百分比衰退。然而，多項因素將支撐電腦產業需求，如多樣化的電腦型態、企業採用新的作業系統、消費者汰換老舊電腦等，以及成長中的高效能應用，包括機器學習、區塊鏈與加密貨幣挖礦。

這些都需要低耗電及高效能的中央處理器、繪圖處理器、硬碟控制器及特殊應用積體電路，並將驅使電腦產業朝向更豐富的半導體內容與更先進製程技術邁進。

●消費性電子

相較於民國一百零五年衰退5%，民國一百零六年消費性電子產業整體單位銷售量衰退4%；除了電視遊樂器銷售量成長外，電視、數位機上盒、MP3播放器、數位相機以及掌上型遊戲機市場則受到電視面板、記憶體價格高居不下，以及功能被智慧型手機所取代的影響，銷售量持續下滑。

民國一百零七年，消費性電子出貨量預計將持續下滑，然而電視遊樂器及4K超高分解度電視將繼續維持高成長，更多的人工智慧如語音辨識、語音控制等功能也將被納入電視及數位機上盒中。預期台積公司將掌握此波趨勢，以廣泛的先進製程技術滿足客戶對市場趨勢之需求。

●物聯網

當愈來愈多的裝置都將被連上網，物聯網正在快速成為一個大趨勢。到了民國一百一十四年，預估物聯網的裝置數目將比智慧型手機的裝置數目多上十倍，受惠於物聯網相關技術的應用及產品，涵蓋智慧型穿戴裝置、家用機器人、智慧電表、智慧製造、自動駕駛車等。這些應用及產品對更長的電池壽命，各種感測器，以及低功耗無線連結上的需求，將挑戰技術發展的新方向。台積公司提供的超低功耗邏輯、射頻方案以及各種感測技術，將引領物聯網未來成長的方向。

產業供應鏈

電子產品的供應鏈冗長而複雜，且各個環節環環相扣。身處產業鏈的上游，半導體元件供應商必須提供充足且即時的產能以因應市場的激烈變化，而積體電路製造服務更是確保產業鏈健康、穩健的重要元素。台積公司身為積體電路製造服務領域的領導者，將持續提供最先進的製程技術及充足的產能，以確保整體產業的持續創新。

2.2.4 台積公司之市場定位、差異化與策略

台積公司的市場定位

台積公司在先進製程技術及特殊製程技術的發展上持續領先全球專業積體電路製造服務領域，民國一百零六年的市場佔有率為56%。台積公司總體營收以地區劃分（主要依據客戶營運總部所在地），其中來自北美市場的營收佔台積公司總體營收的64%、日本與中國大陸以外的亞太市場佔11%、中國大陸市場佔11%、歐洲、中東及非洲市場佔7%、日本市場佔7%；依據終端產品市場來區分，電腦相關產品佔台積公司總體營收的10%、通訊相關產品佔59%、消費性電子產品佔8%、工業及標準性產品則佔23%。

台積公司的差異化優勢

台積公司在業界的領導地位奠基於「先進技術、卓越製造、客戶信任」的三大差異化競爭優勢以及優異的業務策略。

身為技術領導者，台積公司一直以來均是首家推出最新世代技術的專業積體電路製造服務公司；同時，台積公司也在較成熟的技術世代取得領先地位，此係台積公司應用先進技術開發的經驗將更先進的製程技術導入較成熟的特殊製程技術所致。此外，台積公司優異的前段及後段製程整合能力提供功耗、效能以及晶片尺寸最佳化的競爭優勢，並能夠協助客戶快速進入生產。

根植於領先業界的製造管理能力，台積公司在專業積體電路製造方面已經獲得高度肯定；而「開放創新平台」（Open Innovation Platform® Initiative）以及台積大聯盟（TSMC Grand Alliance），則更進一步強化台積公司的領導地位。台積公司的「開放創新平台」加速半導體設計產業與台積公司矽智財夥伴的創新、台積公司自有矽智財的開發、設計實現與可製造性生產的能力，並強化前段製程技術與後段服務。「開放創新平台」是一個完整的設計生態系統，藉由台積公司所開發、支援的協同合作平台，加速供應鏈各方面的創新，因而產生並共享新增的營收與獲利；而台積大聯盟則是由台積公司客戶、電子設計自動化夥伴、矽智財夥伴、主要設備及原物料供應商與台積公司所共同組成，是半導體產業中最強而有力的創新動能之一。透過此一嶄新、更高層次的協同合作，希望能夠協助客戶、聯盟成員及台積公司都能贏得業務並強化競爭優勢。

台積公司自民國七十六年成立以來，始終秉持「絕對不與客戶競爭」的承諾，而這正是客戶信任台積公司的基礎。正因如此，台積公司從未開發或行銷任何一個自有品牌的晶片產品，而是投注公司所有資源成為客戶所信賴的專業積體電路製造服務公司。

台積公司策略

台積公司深信，差異化的競爭優勢將使台積公司更能把握未來積體電路製造服務領域的成長機會。因應行動裝置、高效能運算、汽車電子及物聯網四個快速成長的主要市場，及客戶需求從以製程技術為中心轉變為以產品應用為中心，台積公司已經分別建構四個不同的技術平台，提供

客戶業界最完備且最具競爭優勢的邏輯製程技術、特殊製程技術、矽智財以及封裝測試技術，協助客戶縮短晶片設計時程及加速產品上市速度。

行動裝置平台：台積公司針對客戶在頂級（Premium）產品的應用，提供領先的7奈米FinFET、10奈米FinFET、16奈米FinFET強效版、20奈米系統單晶片等邏輯製程技術以及完備的矽智財，更進一步提升晶片效能、降低功耗及晶片尺寸大小。針對客戶在低階到高階產品的應用，則提供領先的12奈米FinFET精簡型、16奈米FinFET精簡型、28奈米高效能精簡型製程技術、28奈米高效能精簡型強效版製程技術，和22奈米超低功耗等不同邏輯製程選項以及完備的矽智財，滿足客戶對高效能、低功耗晶片產品的需求。此外，不論頂級、高階、中階或低階產品應用，也提供客戶領先業界且最具競爭力的射頻、嵌入式快閃記憶體、新興記憶體、電源管理、感測器、顯示晶片等特殊製程技術，以及涵蓋領先的整合型扇出（InFO）等多種先進封裝技術。

高效能運算平台：台積公司提供領先的7奈米FinFET和16奈米FinFET等邏輯製程技術，以及包括高速互連技術等完備的矽智財，來滿足客戶對資料高速運算與傳輸的需求。台積公司也提供涵蓋領先的CoWoS®和3D IC等多種先進封裝技術，能夠成功完成異質和同質晶片整合，以滿足客戶對運算效能、功耗以及系統設備空間的需求。台積公司將持續優化高性能運算平台，協助客戶贏取由海量數據和應用創新所驅動的市場成長。

汽車電子平台：台積公司提供客戶涵蓋領先的7奈米FinFET、16奈米FinFET、28奈米到40奈米的邏輯製程技術、領先且最具競爭力的多樣射頻、嵌入式快閃記憶體、感測器、多種通過美國汽車電子協會AEC-Q100等級製程規格驗證的電源管理等特殊製程技術。

物聯網平台：提供業界領先且最完備的超低功耗技術平台來支援物聯網及穿戴式裝置的產品創新。台積公司領先的55奈米ULP技術、40奈米ULP技術、28奈米ULP技術，

以及22奈米ULP／超低漏電技術，已被各種穿戴式及物聯網應用廣泛採用。台積公司更進一步，將超低功耗技術擴展到近閾值電壓（Near-Vt）技術以滿足極低功耗產品應用。同時，台積公司也提供客戶領先業界且最具競爭力的多樣射頻、嵌入式快閃記憶體、新興記憶體、感測器、顯示晶片等特殊製程技術，與涵蓋領先的整合型扇出等多種先進封裝技術。

台積公司將繼續強化其核心競爭力，適切規劃公司長短期技術及業務發展策略，並協助我們的客戶因應電子產品週期快速汰換以及市場上激烈競爭的挑戰，以達成投資報酬率與成長目標。

●短期業務發展計劃

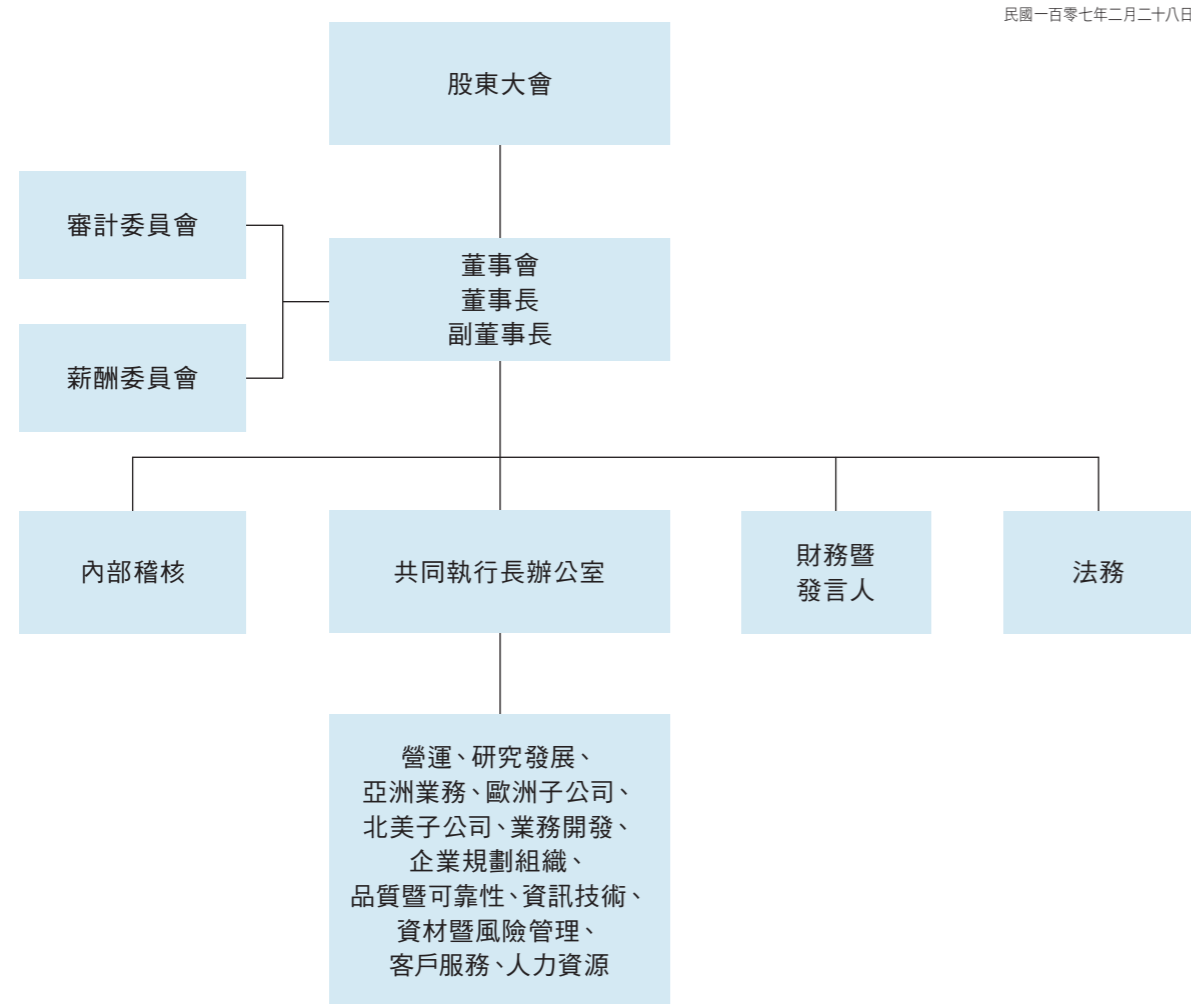
1. 持續投資擴充產能及研發，以擴大市場及維持先進製程技術的市場佔有率。
2. 針對現有成熟技術，開發新客戶及新的應用領域，以維持台積公司在主流技術製程的市場佔有率。
3. 持續強化行動裝置、高效能運算、汽車電子及物聯網技術平台的競爭優勢，以擴展台積公司在這些產品應用的專業積體電路製造服務業務。
4. 進一步拓展台積公司在新興市場及發展中市場的業務與服務。

●長期業務發展計劃

1. 依據摩爾定律，持續向前推進先進製程技術。
2. 進一步發展衍生性半導體製程技術，來增加特殊製程相關應用對營業的貢獻。
3. 提供更多整合服務，涵蓋產品系統整合設計（System-Level Integration Design）、設計技術定義、設計工具發展、晶圓製造及後段封裝測試，透過最佳化解決方案為客戶提供更高的價值。

2.3 公司組織

2.3.1 組織圖



2.3.2 組織功能介紹

營運

- 所有生產廠區之營運管理，含台灣及海外廠區；亦負責產品的發展、製造技術的開發，及後段技術的發展、生產暨服務整合

研究發展

- 先進與特殊製程技術開發、前瞻性技術研究及設計暨技術平台發展

亞洲業務

- 亞洲客戶業務及區域市場發展，並提供技術支援與服務，含中國、日本、韓國及台灣等地區

歐洲子公司

- 歐洲客戶技術行銷，並提供技術支援與服務

北美子公司

- 北美客戶業務及區域市場發展，並提供技術支援與服務

業務開發

- 電子相關產品業務開發、新產品應用，及特殊技術市場開發；並負責持續開發新市場、強化客戶關係及管理企業品牌

企業規劃組織

- 營運資源規劃及製造與業務需求規劃，同時負責整合企業流程、針對公司產品進行定價，且執行市場分析及預測

品質暨可靠性

- 解決新製程開發時的可靠性問題，改善並管理量產時的品質，提供客戶品質問題的解決方案，並提供先進材料與故障分析等服務，以確保公司產品品質及可靠性

資訊技術

- 整合技術及企業資訊系統，並提供資訊建構及通訊服務，確保資訊安全與服務品質，並致力協助各單位運用大數據提升營運效率與研發速度

資材暨風險管理

- 採購、倉儲、進出口、運籌管理，及環境保護、工業安全、職業衛生與風險管理

客戶服務

- 亞洲、歐洲、北美地區客戶支援及服務

人力資源

- 人力資源管理及組織發展，同時負責機密資訊保護與實體安全控管

內部稽核

- 獨立評估內部風險控制制度，檢視此制度設計完備性及執行有效性，以確保遵循公司政策程序及政府法令規章

財務暨發言人

- 公司財務、會計以及企業訊息發布；組織最高主管同時擔任公司發言人的角色

法務

- 公司法務相關業務，含國內外法規遵循、商務合約、專利及其他智慧財產權管理、訴訟等

2.4 董事會成員

2.4.1 董事會成員簡介

截至民國一百零七年二月二十八日止

職稱 姓名	性別	國籍或 註冊地	選(就)任 日期(註一)	任期至 (註一)	初次選任日期 (註一)	選任時持有股份		現在持有股數(註二)		配偶、未成年子女現在持有股份(註二)		主要經/學歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
						股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率		
董事長 張忠謀	男	美國	104/06/09	107/06/08	75/12/10	125,137,914	0.48%	125,137,914	0.48%	135,217	0.00%	美國麻省理工學院機械工程學士及碩士 美國史丹福大學電機工程博士 前美國德州儀器公司總公司集團副總裁 前美國通用儀器公司總裁暨營運長 前財團法人工業技術研究院董事長 前台積公司總執行長 美國國家工程學院院士 美國麻省理工學院終身榮譽理事 美國電腦歷史博物館院士 財團法人工業技術研究院院士 台灣半導體產業協會名譽理事長	無
副董事長 曾繁城	男	中華民國	104/06/09	107/06/08	86/05/13	34,472,675	0.13%	34,472,675	0.13%	132,855	0.00%	國立成功大學電機工程學士 國立交通大學電機工程碩士 國立成功大學電機工程博士 國立交通大學名譽博士 國立清華大學名譽博士 前世界先進積體電路(股)公司總經理 前台積公司總經理 前台積公司副總執行長 前財團法人國家文化藝術基金會董事 財團法人台積電文教基金會董事長	擔任董事長職位： - 台積電(中國)有限公司(非公開發行公司) - 創意電子(股)公司 世界先進積體電路(股)公司副董事長 宏碁(股)公司獨立董事、審計委員會主席及薪酬委員會委員
董事 行政院國家發展基金管理會(註三) 代表人： 陳美伶	女	中華民國	104/06/09	107/06/08	75/12/10 106/11/07 (註四)	1,653,709,980	6.38%	1,653,709,980	6.38%	-	-	國立政治大學法學士 國立台灣大學法學碩士 國立政治大學法學博士 前中華民國法務部法律事務司司長 前中華民國行政院法規委員會主任委員兼訴願審議委員會主任委員 前中華民國行政院副秘書長 前中華民國台南市政府秘書長 前中華民國行政院秘書長 前中國文化大學法律系副教授 中華民國行政院政務委員兼國家發展委員會主任委員	無
董事 劉德音(註五)	男	美國	106/06/08	107/06/08	106/06/08	12,977,114	0.05%	12,913,114	0.05%	-	-	國立台灣大學電機系學士 美國加州大學柏克萊分校電機暨電腦資訊碩士及博士 前世大積體電路製造(股)公司總經理 前台積公司先進技術事業資深副總經理 前台積公司營運資深副總經理 前台積公司執行副總經理暨共同營運長	台積公司總經理暨共同執行長

(接次頁)

職稱姓名	性別	國籍或註冊地	選(就)任日期(註一)	任期至(註一)	初次選任日期(註一)	選任時持有股份		現在持有股數(註二)		配偶、未成年子女現在持有股份(註二)		主要經/學歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
						股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率		
董事 魏哲家(註五)	男	中華民國	106/06/08	107/06/08	106/06/08	7,179,207	0.03%	7,179,207	0.03%	261	0.00%	國立交通大學電機工程學士及碩士 美國耶魯大學電機工程博士 前新加坡特許半導體公司資深副總經理 前台積公司主流技術事業資深副總經理 前台積公司業務開發資深副總經理 前台積公司執行副總經理暨共同營運長 台灣半導體產業協會理事長 財團法人台積電慈善基金會董事	台積公司總經理暨共同執行長 台積電(南京)有限公司董事長(非開發行公司)
獨立董事 彼得·邦菲爵士	男	英國	104/06/09	107/06/08	91/05/07	-	-	-	-	-	-	英國Loughborough大學工程學士 英國Loughborough大學工程學士(Honours Degree) 前ICL Plc董事長暨執行長 前英國電信公司執行長及Executive Committee主席 前英國品質基金會副總裁 前Mentor Graphics公司董事(美國) 前Sony公司董事(日本) 前G3 Good Governance Group資深顧問(倫敦) 倫敦皇家工程學院院士 英國Loughborough大學Council and Senior Pro-Chancellor主席	擔任董事長職位： - 恩智浦半導體公司(荷蘭) - GlobalLogic公司(美國)(非開發行公司) The Longreach Group諮詢委員會委員(香港) Board Mentor, CMI(英國) 擔任資深顧問職位： - Alix Partners(倫敦) - Hampton Group(倫敦)
獨立董事 施振榮	男	中華民國	104/06/09	107/06/08	89/04/14	1,480,286	0.01%	1,480,286	0.01%	16,116	0.00%	國立交通大學電子工程學士及碩士 國立交通大學名譽工程學博士 香港理工大學榮譽科技博士 英國威爾斯大學榮譽院士 美國桑德博管理研究所國際法榮譽博士 宏碁集團創辦人暨榮譽董事長 前宏碁集團董事長暨執行長 前住世達科技(股)公司董事 前財團法人國家文化藝術基金會董事長 財團法人公共電視文化事業基金會董事 亞洲公司治理協會理事 財團法人智榮文教基金會董事長	宏碁(股)公司董事暨榮譽董事長 擔任董事職位： - 緯創資通(股)公司 - 南山人壽保險(股)公司 - 神盾(股)公司 - 大橡(股)公司(非開發行公司) - 中華電視(股)公司
獨立董事 湯馬斯·廷吉布斯	男	美國	104/06/09	107/06/08	98/06/10	-	-	-	-	-	-	美國普渡大學電機工程學士及碩士 美國普渡大學電機工程榮譽博士 前美國德州儀器公司執行副總經理暨半導體集團總經理 前美國德州儀器公司總經理暨總執行長 前美國德州儀器公司董事長 前Catalyst董事長 前美國J. C. Penney公司董事長 前美國J. C. Penney公司首席董事 美國國家工程學院院士 Texas Business Hall of Fame會員 Catalyst榮譽董事 美國Southwestern Medical基金會榮譽理事	無

(接次頁)

職稱 姓名	性別	國籍或 註冊地	選(就)任 日期(註一)	任期至 (註一)	初次選任日期 (註一)	選任時持有股份		現在持有股數(註二)		配偶、未成年子女現在持有股份(註二)		主要經/學歷	目前兼任本公司及其他公司之職務
						股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例		
獨立董事 陳國慈	女	中華民國	104/06/09	107/06/08	100/06/09	-	-	-	-	5,120	0.00%	英國Inns of Court School of Law 英國大律師資格 新加坡律師資格 美國加州律師資格 新加坡陳材清法律事務所律師, 1969-1970 美國紐約Sullivan & Cromwell法律事務所律師, 1971-1974 美國舊金山Heller, Erhman, White & McAuliffe法律事務所律師, 1974-1975 聯鼎法律事務所合夥人, 1975-1988 國振法律事務所合夥人, 1988-1992 漢聲出版社副總經理, 1992-1995 財團法人國家文化藝術基金會執行長, 1995-1997 台積公司資深副總經理暨法務長, 1997-2001 「台北故事館」創辦人/總監, 2003-2015 中華民國行政院政務顧問, 2009-2016 財團法人國家文化藝術基金會董事, 2011-2016 國家表演藝術中心董事長, 2014-2017.01 新加坡南洋大學講師, 1970-1971 東吳大學副教授, 1981-1998 國立清華大學客座教授, 1999-2002 國立政治大學教授, 2001-2004 東吳大學教授, 2001-2008 「迪化二〇七博物館」創辦人暨總監 財團法人中華民國婦癌基金會董事	無
獨立董事 麥克·史賓林特	男	美國	104/06/09	107/06/08	104/06/09	-	-	-	-	-	-	美國威斯康辛大學麥迪森分校電機工程學士及碩士 美國威斯康辛大學麥迪森分校工程榮譽博士 前美國英特爾公司技術與製造事業群執行副總裁 前美國英特爾公司全球業務行銷執行副總裁 前美國應用材料公司執行長 前美國應用材料公司董事長 前美國The NASDAQ OMX Group公司董事 前矽谷領袖集團董事(Silicon Valley Leadership Group) 前國際半導體設備暨材料協會董事(SEMI) 美國威斯康辛大學基金會董事	NASDAQ公司董事長(美國) 擔任董事職位: - Pica8公司(美國)(非公開發行公司) - Meyer Burger Technology Ltd.(瑞士) WISC Partners創投基金合夥人(General Partner)

附註:

1. 董事利用他人名義持有台積公司股份: 無
2. 董事有配偶或二親等內之親屬擔任台積公司之主管或董事: 無

註一: 民國年/月/日

註二: 截至民國一百零七年二月二十八日實際持有股數。

註三: 該法人股東之主要股東

法人股東名稱	法人股東之主要股東(股權比例佔前十名之股東名稱)
行政院國家發展基金管理會	不適用

該法人股東其主要股東為法人者: 不適用。

註四: 行政院國家發展基金管理會於民國一百零六年十一月七日改派代表, 由陳美伶女士接替李鍾熙先生擔任台積公司董事。

註五: 劉德音博士與魏哲家博士於民國一百零六年六月八日股東會新當選為本公司董事。

2.4.2 董事酬金 (註一)

單位：新台幣元

職稱 姓名	董事酬金								A、B、C及D等四項 總額佔稅後淨利 之比例(%)		兼任員工領取之相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項 總額佔稅後淨利之 比例(%) (註六)		領取來自子公司 以外轉投資事業 酬金
	報酬 (A)		退職退休金 (B) (註四)		董事酬勞 (C)		業務執行費用 (D) (註五)				薪資、獎金及 特支費等 (E) (註五)		退職退休金 (F) (註四)		員工酬勞 (G)						
	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司	財務報告內 所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內 所有公司			
														現金金額	股票金額	現金金額	股票金額				
董事長 張忠謀	23,006,760	23,006,760	506,504	506,504	281,884,700	281,884,700	4,084,839	4,084,839	0.0901%	0.0901%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0901%	0.0901%	-
副董事長 曾繁城	12,972,120	12,972,120	285,586	285,586	9,600,000	9,600,000	2,647,286	2,647,286	0.0074%	0.0074%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0074%	0.0074%	6,381,650
董事 行政院國家發展基金管理會 (註二) 代表人： 陳美伶	-	-	-	-	9,600,000	9,600,000	-	-	0.0028%	0.0028%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0028%	0.0028%	-
董事 劉德音 (註三)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,393,154	111,393,154	215,251	215,251	99,883,980	-	99,883,980	-	0.0616%	0.0616%	-
董事 魏哲家 (註三)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,547,115	111,547,115	215,251	215,251	99,883,980	-	99,883,980	-	0.0617%	0.0617%	-
獨立董事 彼得·邦菲爾士	-	-	-	-	14,611,560	14,611,560	-	-	0.0043%	0.0043%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0043%	0.0043%	-
獨立董事 施振榮	-	-	-	-	12,000,000	12,000,000	-	-	0.0035%	0.0035%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0035%	0.0035%	-
獨立董事 湯馬斯·延吉布斯	-	-	-	-	14,611,560	14,611,560	-	-	0.0043%	0.0043%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0043%	0.0043%	-
獨立董事 陳國慈	-	-	-	-	12,000,000	12,000,000	-	-	0.0035%	0.0035%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0035%	0.0035%	-
獨立董事 麥克·史賓林特	-	-	-	-	14,611,560	14,611,560	-	-	0.0043%	0.0043%	-	-	-	-	-	-	-	-	0.0043%	0.0043%	-
總計	35,978,880	35,978,880	792,090	792,090	368,919,380	368,919,380	6,732,125	6,732,125	0.1202%	0.1202%	222,940,269	222,940,269	430,502	430,502	199,767,960	-	199,767,960	-	0.2435%	0.2435%	6,381,650

*除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務 (如擔任非屬員工之顧問等) 領取之酬金：無

註一：台積公司給付董事酬金之政策、標準與組合、程序、與經營績效及未來風險之關聯性：本公司董事長、副董事長及董事之報酬，依公司章程之規定決定之。此外，公司章程亦規定公司應提撥年度獲利不低於0.3%作為董事酬勞，且董事酬勞給付之對象，不包括兼任經理人之董事。董事酬勞之給付，依本公司「董事酬勞給付辦法」之規定辦理。

註二：行政院國家發展基金管理會於民國一百零六年十一月七日改派代表，由陳美伶女士接替李鍾熙先生擔任台積公司董事。

註三：劉德音博士與魏哲家博士於民國一百零六年六月八日股東會新當選為本公司董事。因兼任經理人，故不參與董事酬勞之分配。

註四：此為依法提撥/給付之退休金。

註五：此費用包含公司配車費用及油資補貼，但不包括給付司機之相關報酬計新台幣6,640,379元。

註六：本公司及財務報告內所有公司於民國一百零五年支付董事酬金皆為新台幣415,976,199元，佔民國一百零五年度稅後淨利皆為0.1244%。

2.5 主要經理人

2.5.1 主要經理人資料

截至民國一百零七年二月二十八日止

職稱 姓名	性別	國籍	就任日期 (註一)	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要學/經歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管		
				股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
總經理暨共同執行長 劉德音	男	美國	82/11/15	12,913,114	0.05%	-	-	-	-	美國加州大學柏克萊分校電機暨電腦資訊博士 台積公司執行副總經理暨共同營運長 台積公司營運資深副總經理 台積公司先進技術事業資深副總經理 世大積體電路製造公司總經理	無	無	無	無
總經理暨共同執行長 魏哲家	男	中華民國	87/02/01	7,179,207	0.03%	261	0.00%	-	-	美國耶魯大學電機工程博士 台積公司執行副總經理暨共同營運長 台積公司業務開發資深副總經理 台積公司主流技術事業資深副總經理 新加坡特許半導體公司資深副總經理	台積公司所屬子公司董事	無	無	無
資訊技術/資材暨風險管理 資深副總經理暨資訊長 左大川(註二)	男	中華民國	85/12/16	12,222,064	0.05%	-	-	-	-	美國加州大學柏克萊分校材料科學暨工程博士 美國WaferTech公司總經理 台積公司營運組織資深副總經理 應用材料公司CVD部門總經理	台積公司所屬子公司董事	無	無	無
財務 資深副總經理暨財務長兼發言人 何麗梅	女	中華民國	88/06/01	4,481,080	0.02%	2,230,268	0.01%	-	-	國立台灣大學商學碩士 台積公司會計處協理 德基半導體公司副總經理暨財務長	台積公司所屬子公司董事/監察人 台積公司轉投資公司董事 台積公司所屬子公司總經理	無	無	無
研究發展/技術發展 資深副總經理 羅唯仁	男	中華民國	93/07/01	1,444,127	0.01%	-	-	-	-	美國加州大學柏克萊分校固態物理及表面化學博士 台積公司研究發展副總經理 台積公司營運組織製造技術副總經理 台積公司先進技術事業副總經理 台積公司營運組織二副總經理 美國英特爾公司先進技術發展協理暨CTM廠長	無	無	無	無
資深副總經理暨 北美子公司執行長 瑞克·凱希迪	男	美國	86/11/14	-	-	-	-	-	-	美國西點軍校工程學士 台積公司北美子公司總經理 台積公司北美子公司客戶管理副總經理	台積公司所屬子公司董事	無	無	無
營運/產品發展 資深副總經理 秦永沛	男	中華民國	76/01/01	6,922,122	0.03%	2,193,107	0.01%	-	-	國立成功大學電機工程碩士 台積公司營運組織產品發展副總經理 台積公司先進技術事業副總經理 台積公司產品工程暨服務處資深處長	無	無	無	無
研究發展/技術發展 資深副總經理 米玉傑	男	中華民國	83/11/14	1,000,419	0.00%	-	-	-	-	美國洛杉磯加州州立大學電機工程博士 台積公司技術發展副總經理 台積公司研發平台一處資深處長	無	處長	Wayne Yeh	姊夫
營運/協力廠 副總經理 曾孟超	男	中華民國	76/01/01	7,145,595	0.03%	-	-	-	-	中原大學應用化學碩士 台積公司主流技術事業副總經理 台積公司營運組織一副總經理 台積公司營運組織二廠資深協理	台積公司所屬子公司董事 台積公司轉投資公司董事	副處長	曾孟堅	兄弟
研究發展/技術研究 副總經理暨技術長 孫元成	男	中華民國	86/06/02	3,913,831	0.02%	-	-	-	-	美國伊利諾大學香檳分校電機工程博士 台積公司研究發展副總經理 台積公司邏輯技術發展處資深處長 美國國際商用機器公司 (IBM) 研發部門資深經理	無	無	無	無
品質暨可靠性 副總經理 蔡能賢	男	中華民國	89/03/01	1,961,180	0.01%	1,103,253	0.00%	-	-	美國麻省理工學院材料工程博士 台積公司封裝測試技術暨服務處資深處長 世界先進積體電路(股)公司營運組織副總經理	無	無	無	無
營運/六吋及八吋廠暨製造技術 副總經理 林錦坤(註三)	男	中華民國	76/01/01	12,518,018	0.05%	1,073,387	0.00%	-	-	國立彰化師範大學工業教育系學士 台積公司成熟技術事業總廠長	台積公司所屬子公司董事 台積公司轉投資公司董事	無	無	無

(接次頁)

職稱 姓名	性別	國籍	就任日期 (註一)	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份		主要學/經歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管		
				股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例			職稱	姓名	關係
營運/十二吋廠 副總經理 王建光	男	中華民國	76/02/11	2,553,947	0.01%	160,844	0.00%	-	-	國立成功大學化學工程碩士 台積公司營運組織十二吋廠總廠長	台積公司所屬子公司董事	無	無	無
企業規劃組織 副總經理 孫中平	女	中華民國	92/10/01	420,709	0.00%	-	-	-	-	美國康乃爾大學材料科學暨工程博士 台積公司企業規劃組織協理	無	無	無	無
研究發展/設計暨技術平台 副總經理 侯永清	男	中華民國	86/12/15	352,532	0.00%	60,802	0.00%	-	-	美國紐約雪城大學電機博士 台積公司設計暨技術平台組織資深處長	台積公司所屬子公司董事 台積公司轉投資公司董事 台積公司所屬子公司總經理	無	無	無
業務開發 副總經理 金平中	女	中華民國	98/04/30	320,000	0.00%	53,000	0.00%	-	-	美國南加州大學化學博士 台積公司業務開發組織長 上海宏力半導體公司研發副總經理 美國英特爾公司技術研發處長	無	無	無	無
法務 副總經理暨法務長 方淑華	女	中華民國	84/03/20	700,285	0.00%	419,112	0.00%	34,000	0.00%	美國愛荷華大學比較法學碩士 台灣律師資格 台積公司副法務長 台灣國際專利法律事務所資深律師	台積公司所屬子公司董事/監察人	無	無	無
人力資源 副總經理 馬慧凡	女	中華民國	103/06/01	80,000	0.00%	-	-	-	-	國立台灣大學國際企業管理碩士 台積公司人力資源組織長 趨勢科技人力資源資深副總經理	無	無	無	無
研究發展/技術發展 副總經理 王英郎	男	中華民國	81/06/01	218,535	0.00%	1,135,529	0.00%	-	-	國立交通大學電子工程博士 台積公司營運組織十四B廠副總經理 台積公司營運組織十四B廠資深處長	無	無	無	無
研究發展/Integrated Interconnect & Packaging 副總經理 余振華	男	中華民國	83/12/28	225,000	0.00%	-	-	-	-	美國喬治亞理工學院材料工程博士 台積公司研究開發組織Integrated Interconnect & Packaging處資深處長	無	無	無	無
研究發展/特殊技術 副總經理、台積科技院士 亞歷山大·卡利尼斯基	男	美國	98/06/15	-	-	-	-	-	-	加拿大卡爾頓大學電機工程博士 台積公司研究開發組織特殊技術處資深處長	無	無	無	無
業務開發 副總經理 張曉強	男	美國	105/11/01	-	-	-	-	-	-	美國杜克大學電機工程博士 台積公司設計暨技術平台副總經理 美國英特爾公司技術與製造副總經理	無	無	無	無
營運/十二吋廠/十二B廠 副總經理、台積科技院士 張宗生(註四)	男	中華民國	84/02/06	200,781	0.00%	-	-	-	-	國立清華大學電機工程博士 台積公司營運組織十二B廠資深處長	無	無	無	無
研究發展/技術發展/ 3奈米平台研發處 副總經理 吳顯揚(註四)	男	中華民國	85/12/09	468,501	0.00%	176,943	0.00%	-	-	美國威斯康辛大學麥迪森分校電機工程博士 台積公司研究開發組織3奈米平台研發處資深處長	無	無	無	無
研究發展/技術發展/ Pathfinding 副總經理 曹敏(註四)	男	美國	91/07/29	353,152	0.00%	4,470	0.00%	-	-	美國史丹佛大學物理博士 台積公司研究開發組織Pathfinding處資深處長	無	無	無	無

註一：此就任日期為加入台積公司之日期(民國年/月/日)。

註二：資深副總經理暨資訊長左大川博士於民國一百零七年三月一日退休。

註三：副總經理林錦坤先生於民國一百零七年三月一日起同時擔任資材暨風險管理組織主管。

註四：張宗生博士、吳顯揚博士與曹敏博士於民國一百零七年二月十三日獲擢升為副總經理。

2.5.2 總經理暨共同執行長及副總經理之酬金（註一）

單位：新台幣元

職稱	姓名	薪資 (A)		退職退休金 (B) (註五)		獎金、特支費等 (C) (註六)		員工酬勞金額 (D)				A、B、C及D前四項總額佔稅後淨利之比例 (%) (註七)		領取來自子公司以外轉投資事業酬金
		本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司	財務報告內所有公司	本公司		財務報告內所有公司		本公司	財務報告內所有公司	
								現金金額	股票金額	現金金額	股票金額			
總經理暨共同執行長	劉德音	8,371,830	8,371,830	215,251	215,251	103,021,324	103,021,324	99,883,980	-	99,883,980	-	0.0616%	0.0616%	-
總經理暨共同執行長	魏哲家	8,371,830	8,371,830	215,251	215,251	103,175,285	103,175,285	99,883,980	-	99,883,980	-	0.0617%	0.0617%	-
財務資深副總經理暨財務長兼發言人	何麗梅	5,384,970	5,384,970	138,456	138,456	46,020,375	46,020,375	44,099,530	-	44,099,530	-	0.0279%	0.0279%	-
資訊技術／資材暨風險管理資深副總經理暨資訊長	左大川 (註二)	78,328,182	92,249,546	2,013,760	2,365,597	549,707,037	634,894,097	504,799,711	-	504,799,711	-	0.3308%	0.3597%	120,000
研究發展／技術發展資深副總經理	羅唯仁													
資深副總經理暨北美子公司執行長	瑞克·凱希迪													
營運／產品發展資深副總經理	秦永沛													
研究發展／技術發展資深副總經理	米玉傑													
營運／協力廠副總經理	曾孟超													
研究發展／技術研究副總經理暨技術長	孫元成													
品質暨可靠性副總經理	蔡能賢													
營運／六吋及八吋廠暨製造技術副總經理	林錦坤 (註三)													
營運／十二吋廠副總經理	王建光													
企業規劃組織副總經理	孫中平													
研究發展／設計暨技術平台副總經理	侯永清													
業務開發副總經理	金平中													
法務副總經理暨法務長	方淑華													
人力資源副總經理	馬慧凡													
研究發展／技術發展副總經理	王英郎													
研究發展／Integrated Interconnect & Packaging副總經理	余振華													
研究發展／特殊技術副總經理、台積科技院士	亞歷山大·卡利尼斯基													
業務開發副總經理	張曉強													
營運／十二吋廠／十二B廠副總經理、台積科技院士	張宗生 (註四)													
研究發展／技術發展／3奈米平台研發處副總經理	吳顯揚 (註四)													
研究發展／技術發展／Pathfinding副總經理	曹敏 (註四)													
總計		100,456,812	114,378,176	2,582,718	2,934,555	801,924,021	887,111,081	748,667,201	-	748,667,201	-	0.4820%	0.5109%	120,000

註一：台積公司給付經理人酬金之政策、標準與組合、程序及與經營績效及未來風險之關聯性：本公司總經理暨共同執行長、財務長及法務長獲派之酬金金額，乃依其職務、貢獻、該年度公司經營績效及考量公司未來風險，由董事長評量提案，提交至薪酬委員會審議並送交董事會決議；其他經理人的酬金金額由董事長及總經理暨共同執行長一同評量提案，提交至薪酬委員會審議並送交董事會決議。

註二：資深副總經理暨資訊長左大川博士於民國一百零七年三月一日退休。

註三：副總經理林錦坤先生於民國一百零七年三月一日起同時擔任資材暨風險管理組織主管。

註四：張宗生博士、吳顯揚博士與曹敏博士於民國一百零七年二月十三日獲擢升為副總經理，故民國一百零六年度無申報金額。

註五：此為依法提繳／給付之退休金。

註六：此費用包含公司民國一百零六年五月、八月、十一月及民國一百零七年二月發放之員工現金獎金及配車費用、油資補貼，但不包括給付司機之相關報酬（計新台幣3,455,753元）。

註七：本公司於民國一百零五年支付予經理人之酬金為新台幣1,506,047,477元，佔民國一百零五年度稅後淨利0.451%；財務報告內所有公司於民國一百零五年支付予經理人之酬金為新台幣1,603,740,033元，佔民國一百零五年度稅後淨利0.480%。

給付總經理暨共同執行長及副總經理酬金級距

	民國106年度	
	本公司	本公司及所有轉投資事業
0元 ~ 2,000,000元 (不含)	瑞克·凱希迪	無
2,000,000元 (含) ~ 5,000,000元 (不含)	無	無
5,000,000元 (含) ~ 10,000,000元 (不含)	無	無
10,000,000元 (含) ~ 15,000,000元 (不含)	無	無
15,000,000元 (含) ~ 30,000,000元 (不含)	無	無
30,000,000元 (含) ~ 50,000,000元 (不含)	孫中平、金平中、方淑華、馬慧凡、王英郎、余振華	孫中平、金平中、方淑華、馬慧凡、王英郎、余振華
50,000,000元 (含) ~ 100,000,000元 (不含)	何麗梅、秦永沛、米玉傑、曾孟超、孫元成、蔡能賢、林錦坤、王建光、侯永清、亞歷山大·卡利尼斯基、張曉強	何麗梅、瑞克·凱希迪、秦永沛、米玉傑、曾孟超、孫元成、蔡能賢、林錦坤、王建光、侯永清、亞歷山大·卡利尼斯基、張曉強
100,000,000元以上	劉德音、魏哲家、左大川、羅唯仁	劉德音、魏哲家、左大川、羅唯仁
總計	22	22

2.5.3 分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣元

職稱	姓名	股票金額	現金金額	總計	總額佔民國106年稅後純益之比例(%)
總經理暨共同執行長	劉德音	-	99,883,980	99,883,980	0.0291%
總經理暨共同執行長	魏哲家	-	99,883,980	99,883,980	0.0291%
財務 資深副總經理暨財務長兼發言人	何麗梅	-	44,099,530	44,099,530	0.0129%
資訊技術／資材暨風險管理 資深副總經理暨資訊長	左大川(註一)				
研究發展／技術發展 資深副總經理	羅唯仁				
資深副總經理暨 北美子公司執行長	瑞克·凱希迪				
營運／產品發展 資深副總經理	秦永沛				
研究發展／技術發展 資深副總經理	米玉傑				
營運／協力廠 副總經理	曾孟超				
研究發展／技術研究 副總經理暨技術長	孫元成				
品質暨可靠性 副總經理	蔡能賢				
營運／六吋及八吋廠暨製造技術 副總經理	林錦坤(註二)				
營運／十二吋廠 副總經理	王建光				
企業規劃組織 副總經理	孫中平				
研究發展／設計暨技術平台 副總經理	侯永清	-	504,799,711	504,799,711	0.1471%
業務開發 副總經理	金平中				
法務 副總經理暨法務長	方淑華				
人力資源 副總經理	馬慧凡				
研究發展／技術發展 副總經理	王英郎				
研究發展／Integrated Interconnect & Packaging 副總經理	余振華				
研究發展／特殊技術 副總經理、台積科技院士	亞歷山大·卡利尼斯基				
業務開發 副總經理	張曉強				
營運／十二吋廠／十二B廠 副總經理、台積科技院士	張宗生(註三)				
研究發展／技術發展／3奈米平台研發處 副總經理	吳顯揚(註三)				
研究發展／技術發展／Pathfinding 副總經理	曹敏(註三)				
總計		-	748,667,201	748,667,201	0.2182%

註一：資深副總經理暨資訊長左大川博士於民國一百零七年三月一日退休。

註二：副總經理林錦坤先生於民國一百零七年三月一日起同時擔任資材暨風險管理組織主管。

註三：張宗生博士、吳顯揚博士與曹敏博士於民國一百零七年二月十三日獲擢升為副總經理，故民國一百零六年度無申報金額。